

“湾区媒体发展联盟”筹备会议在中山召开 首届“湾区文旅推介大会”拟11月举办

本报记者 李鑫 见习记者 张景天
通讯员 梁展宏

5月15日下午,2025年“湾区媒体发展联盟”筹备会议在中山日报社召开。此次会议由深圳宝安日报社和中山日报社联合主办,省内近15家主流媒体代表参会。与会人员围绕如何通过媒体融合推动文旅产业升级、助力区域经济发展展开讨论。会议透露,联盟计划于今年11月在深圳国际会展中心举办首届“湾区文旅推介大会”,发布《湾区文旅精品路线指南》,并启动“群众最喜爱的湾区十大文旅地标”评选活动。

■筹备成立联盟共谋发展新机遇

数字化浪潮下,传统媒体面临转型升级挑战。

中山日报社副总编辑程明盛在致辞中说:“成立联盟,是顺应时代发展之举。媒体不仅是信息传递者,更是文化塑造者和产业推动者,能为区域经济文化产业提供持久动力。”

宝安日报副总编辑王艳也表达期待。她指出,尽管大湾区有丰富的文旅IP,但缺乏系统整合推广。联盟将通过媒体纽带,串联各地文旅资源,借助创新形式推动“媒体+文旅+产业”深度融合,助力湾区文旅品牌走向全国、迈向世界。

“湾区媒体发展联盟”由深圳宝安日报社和中山日报社联合发起,首批成员单位涵盖广州日报、珠海特区报、湛江日报等湾区主流媒体。中山日报社作为发起方之一,近年来在数字化转型、媒体融合及产业拓展方面成效显著。旗下中山

报业传媒股份有限公司接管中山影视城文旅项目运营,在“融媒+文旅”模式探索上积累丰富经验,为联盟成立和发展提供坚实基础。

■“三步走”战略擘画发展新蓝图

会议现场,中山日报社代表详细解读联盟发展规划。据介绍,联盟将实施“三步走”战略,推动稳健发展——

短期目标(1年内):完成湾区文旅融媒体平台建设,举办首届文旅推介大会;中期目标(3年内):吸纳港澳媒体加入,成立文旅产业投资基金;长期目标(5年内):构建全国性产业生态圈,推动国际化合作。

在自由讨论环节,各媒体代表积极建言献策。深圳特区报代表指出,传统媒体面临影响力下降和经营困境,联盟可通过

资源共享、一键分发等方式提高传播力和影响力,同时注入各地优势资源,形成经营性机制,实现可持续发展。湛江日报代表强调,联盟需集中各家所长,形成套餐式方案,解决资源分配和利益共享问题。通过联盟抱团取暖,提升媒体传播力和影响力,应对互联网冲击和市场化竞争。阳江日报代表认为,联盟应考虑成员单位的地域影响力,量身定制合作模式,探索资源共享和需求提交机制,实现联盟持久发展。

其他与会代表也发表见解和建议。大家一致认为,联盟成立将为大湾区媒体发展注入新动能,为区域经济文化产业提供有力支持。据主办方负责人介绍,联盟将以此次会议为起点,携手各成员单位,打造具有国际影响力的媒体合作平台,为大湾区建设贡献媒体力量。

把中国基板“焊进”全球产业链

中山“芯片逐梦人”破局万亿级赛道,用“焊点”书写中国半导体产业突围密码

本报记者 柯颂

5月,粤港澳大湾区半导体产业版图上,一颗“硬核新星”正在中山三角镇高平工业区加速跃动。1.6T高速光模块封装基板产线满负荷运转,月产1000Pnl的基板正源源不断发往国内头部企业。

这家由深南电路前首席专家谷新领衔的初创企业中山市芯承半导体有限公司设厂中山三角镇,用1190个日夜,在日台企业垄断的高端封装基板领域撕开一道“国产替代”的裂缝——从15平方米创业办公室到1.8亿元国资押注,从37天设备调试失败到良率反超国际巨头3个百分点,他们用“焊点”书写着中国半导体产业的突围密码。

■破冰时刻:不做技术“盆景”,到产业战场种“森林”

2022年春,中美半导体博弈正酣。时任深南电路首席研发专家的谷新,在一份《中国半导体进口依赖度报告》前彻夜难眠:全球半导体封装基板市场规模已达千亿元级,而其背后关联的芯片市场规模更在2024年突破6000亿美元,预计2030年将迈向万亿美金新蓝海。

“与其在实验室做技术‘盆景’,不如到产业战场种‘森林’!”这位香港城市大学归来的博士,毅然辞去央企职务,带着20年封装基板技术积淀,拉起一支平均年龄38岁的“工程师敢死队”。创业初期,深圳老旧写字楼里的15平方米办公室,见证了他们的至暗时刻:6张二手办公桌拼成“作战室”,墙面贴满技术参数的便签纸在台风天哗哗作响。

谷新带着团队白天跑客户,晚上用PPT向投资人描绘“国产替代”的星辰大海。当龙芯中科、通富微电等巨头抛来橄榄枝时,选址问题也摆在眼前——长三角抛出优厚条件,而中山国资的1.8亿元投资和“陪企业赌未来”的承诺,让谷新拍板:“我们要找的不仅是政策,更是敢为天下先的‘同路人’!”

■千日淬火:焊出“中国精度”

2023年雨季,芯承半导体迎来首期



中山市芯承半导体有限公司高端智能化车间。

本报记者 文波 摄

厂房装修攻坚战。一场暴雨冲进未完工的无尘车间,设备地基泡在积水中,谷新和团队打着伞调试净化系统,工程师们戏称这是“半导体版《流浪地球》”。

从图纸到量产,10个月“芯承速度”背后,是2000余次基板烧制、37天设备调试失败的至暗时刻。“12微米线宽,相当于头发丝的1/6,误差不能超过睫毛直径!”技术总监蔡琨辰指着显微镜下的线路纹路,指尖微微颤抖。为突破10/10μm线宽线距技术瓶颈,团队搬出深南电路时期的MSAP改良半加成法,在实验室地板上和衣而眠,白板上画满改进方案。当第一片合格基板从产线输出时,鬓角斑白的工艺工程师老陈攥着专利证书,给妻子发去一条颤抖的语音:“咱中国人自己的高端基板,成了!”

市场验证更是一场“极限挑战”。2024年初,面对某头部通讯企业认证团队的质疑,谷新团队现场演示72小时高温高湿测试,基板焊点在极端环境下依然稳如磐石。对方当场拍板试订单。“他们用10年经验烧出的‘土办法’,啃下了进口设备垄断

的硬骨头!”财务总监翻着首笔千万级订单报表,泪水在眼眶里打转。

■裂谷生花:在“卡脖子”处种出“硬核根系”

2024年深秋,第一笔千万级订单到账,芯承半导体迎来历史性拐点。公司产品进入华为、中兴供应链,这群“芯片逐梦人”用3年时间,将“不可能”焊进了电路板。

在样品陈列室,谷新拿起一块比手机摄像头模组更小的滤波器基板:“56层互联线路,良率反超国际巨头3个百分点!”更让团队振奋的是国产替代的加速度:龙芯中科的CPU封装基板、通富微电的存储芯片载体……这些曾被日台企业“卡脖子”的核心部件,正批量换上“芯承制造”的标签。

谷新看着窗外拔地而起的二期厂房:“中山给了我们从零开始的勇气,现在更要证明,粤港澳大湾区不仅能长出电子信息产业集群,更能孕育高端半导体的‘硬核’根系!”

■向“66亿产值”冲锋:让焊点跳动成产业脉搏

目前,芯承实验室里,40人研发团队正在攻克22层FC BGA基板技术——这一连接CPU与PCB的“皇冠明珠”,全球仅少数企业掌握。“我们的设备90%国产化!”谷新点开融资图谱,4.6亿元资本注入背后,是龙芯资本、鼎晖百孚等机构对“中国芯”的坚定押注。按照规划,2026年自建厂房投产后,这里将形成66亿元产值规模。

更宏大的蓝图藏在技术文档里:面向AI算力的1.6T光模块基板已进入客户认证,自动驾驶高可靠性基板完成样品测试。“有人说半导体创业是‘熬鹰’,但我们等的不是对手倒下,而是国产产业链真正站起来的那天!”芯承车间里,年轻工程师们调试着设备。在这片布满代码与公式的电路板上,他们正用焊点书写着当代科技创业者的答卷——不是躺在实验室的论文,而是让“中国芯”成为5G基站、数据中心、自动驾驶里跳动的鲜活史诗。